

Broadcom 发布业界最低功率的万兆以太网 LAN/WAN 收发器

*业界首个万兆以太网物理芯片 (PHY) ,
对多优先级数据处理提供业务感知的流量控制支持*

美国加州阿那罕姆市 - 2006 年光纤通讯研讨会及展览会/美国光纤工程师大会 (OFC/NFOEC)--2006 年 3 月 6 日--全球领先的有线和无线通讯半导体供应商 Broadcom 公司 (Nasdaq: BRCM) 今天发布了万兆以太网 (10GbE) 物理层 (PHY) 芯片, 超越了美国电气电子工程师学会 (IEEE) 对局域网 (LANs) 和广域网 (WANs) 严苛的要求, 并提供了业界最小功率的解决方案。这个新的物理层 (PHY) 芯片能够在现有的同步光纤网络 (SONET)/同步数字体系 (SDH) 骨干网上传输万兆 (10GbE) 数据, 从而进一步拓展了 Broadcom 公司业界领先的以太网平台, 极大提高了在功率、成本和电路板级和模块方面应用的效率。通过业界首次在物理层是支持 Broadcom® StrataXGS® III 服务感知流量控制 (SAFC) 协议, 客户可以为局域网和广域网光线链路上的流量设定优先级。

据 Dell'Oro 市场调查公司预测, 万兆市场前景看好, 万兆端口的销售量将从 2006 年的 854,000 个增加到 2007 年的 187 万个。这是由于语音、数据和视频的融合使带宽的需求大大增加所致。数据类型多样化, 端口数目众多, 意味着网络需要变得越来越灵活, 以便与 LAN 和 SONET/SDH 骨干网接口, 在不同城市和大都市间提供更高速的连接。

由于 SONET/SDH 是高速网络连接的基础, Broadcom 已稳步构建了产品组合, 为万兆 LAN 到 SONET/SDH 网络提供物理层接口支持, Linley 集团高级分析师 Jag Bolaria 称, “有了 Broadcom 在以太网和 SONET 领域的领先地位, 辅之以其系统级的专业知识, 新的低功率万兆 LAN/WAN 物理芯片定能在客户中获得良好的反响。”

新发布的是 Broadcom BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY 的芯片, 在 WAN 模式下, 只需耗电 1.1 瓦, 而在 LAN 模式下, 只需耗电 0.9 瓦, 功率消耗极大降低, 解决了设备设计人员的一大难题。在 WAN 模式下, BCM8705 通过 XAUI 接口从媒体接入控制器 (MAC) 或交换机处获取万兆数据, 并将以太网流量映射到 OC-192 帧, 将系列数据通过 XFI 连接接口传输至 SONET 骨干网, 并同时满足国际电联 (ITU) 对 SONE/SDH 远程网的严苛标准及国际电气电子工程师协会 (IEEE) 对万兆以太网的标准。

“引入这种创新性低功率的 BCM8705 10GbE LAN/WAN 物理层芯片 (PHY), Broadcom 利用其在以太网系统方面的专业特长及其在 SONET/SDH 市场的领先地位开发出的一种顶级产品, 帮助客户减少系统设备实现最终的简单化”, Broadcom 公司光纤业务产品线高级经理 Bob Salem 表示, “我们很高兴看到一种真正的 LAN/WAN PHY 解决方案最终推向市场, 而这一方案正是来自 Broadcom 公司, 我们感到非常欣慰”

BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY 芯片具有无与伦比的独特功能。这些功能包括：

- 支持业务感知的流量控制：与 Broadcom 的以太网交换产品相配套，BCM8705 支持 SAFC，客户从而可以确定每个万兆以太网数据包的优先级依次处理。
- WAN 模式下支持巨型封包，以便传输大型数据文件。
- 完整的 SONET/SDH 性能监控功能块，包括连接外部控制器的一系列专用端口（ITU 网络大多如此要求）。
- 具有多种不同环回模式的 n-芯片内置测试生成器和检测器，可对物理层进行独立诊断。
- 分级设备功率模式，以最大程度减少功率突发电流或热插拔应用。
- 小型无铅包装，13 x 13 毫米的塑料 BGA，节省 PCB 空间，并可支持高密度线卡应用。

购买渠道及定价

一些早期用户正在使用 BCM8705 10GbE LAN/WAN PHY 样品，定价为 OEM 价格每颗 70 美元。批量生产有望在 2006 年第二季度开始。

Broadcom 在 2006 年 3 月 7 日至 9 日于加利福尼亚的阿纳海姆会议中心召开的 2006 年光纤通讯研讨会及展览会/美国光纤工程师大会（OFC/NFOEC）展示了该产品。

Broadcom 还有两个万兆上行模块，八个万兆口交换机，XFP 和 BCM8705 评估板等多种选择供客户设计参考，加速产品上市时间。

关于 Broadcom 公司

Broadcom（博通）公司是全球领先的有线和无线通讯半导体供应商。其产品可实现家用、办公室和移动环境中融合高速数据、高清晰度视频、语音和音频。Broadcom 为计算机和网络设备制造商、数字娱乐和宽带接入产品制造商、移动设备制造商提供业界最为全面且最先进的系统芯片和软件解决方案。这些技术和产品支持我们的核心任务：连接一切®。

Broadcom（博通）公司是全球最大的无生产线半导体公司之一，年营收额超过 25 亿美元。公司总部位于加利福尼亚 Irvine，办公和研发机构遍布北美、亚洲和欧洲。Broadcom（博通）公司联系方式：1-949-450-8700，或访问www.broadcom.com。



报界垂询: 资深公共关系经理 Mike He (Broadcom 行业媒体联系)
00-1-408-922-8083
mhe@broadcom.com

技术咨询: 高级产品经理 Bob Salem (Broadcom 技术联系)
949- 926-6882
bsalem@broadcom.com

投资关系咨询: 投资关系副总裁 T. Peter Andrew (Broadcom 投资关系联系)
00-1-949-926-5663
andrewtp@broadcom.com